

HPW series probe station

A dedicated **0-300 mm manual** probing solution

- Failure analysis 集成电路失效分析
- Wafer level reliability 晶圆可靠性认证
- Device characterization 元器件特性量测
- Process modeling 塑性过程测试(材料特性分析)
- IC Process monitoring 制程监控
- Package part probing IC 封装阶段打线品质测试
- ESD&TDR testing ESD 和 TDR 测试
- Microwave probing 微波量测(高频)
- Solar 太阳能领域检测分析
- LED、OLED、LCD 领域检测分析



(1) 参数列表如下:

项 目		性能指标	备注
可测圆片尺寸		4, 6, 8, 12 inch	
可测电压		3KV; 10KV	
可测电流		10A (DC) ;100A(pluse)	
X、Y 工作台	行程	X/Y: 8inch x 8 inch	根据晶圆尺寸而定
	分辨率	1 μm	
	控制	进口导轨	
CHUCK	平面度	≤10 μm	背面需要加电极(可选)
	晶圆固定方式	真空吸附, 分档控制	
Chuck Z 轴 (可选)	行程	10mm	
	分辨率	1 μm	
Chuck θ 轴 (可选)	微调范围	±7 ° (分辨率为 0.1°)	

仪准科技(香港)有限公司

Advanced Technology Co., Limited

TEL:021-34638926 FAX:021-64051950

Email:cypher_wang@adv-hk.com <http://www.adv-hk.com>

Platen 平台	材料	非抛光型不锈钢+特种铝合金	
	容量	6-8 个 DC 针座或者 4 个 RF 针座	
	微调旋钮	分辨率为 1um 移动范围为 25mm 导轨式移动	
	升降	8mm 行程的升降抬杆, 可锁定 重复度精度为±2um	
上、下片	方式	手动	
	行程	90 mm	
显微镜	配置	(1) 体式显微镜 目镜: 20X 变倍范围: 0.75X-5X 总放大倍数: 15x-100x LED 光源照明 (2) 金相显微镜 目镜: 20x Zoom: 1-2x 物镜: 2x, 10x, 20x, 50x 总放大倍数: 20x-1000x 光纤光源系统	根据客户测试参数要求而定
	行程	X/Y: 2 inch x 2inch (分辨率: 1um) Z: 2inch	
	抬起功能	显微镜可抬起, 便于切换镜头。抬起后可以锁定, 防止掉落。	
屏蔽罩 (可选)		L1350*W900*H1300mm	
防震桌 (可选)		W*D*H: 1100*800*900mm	

(2) 可选附件:

- 射频测试探头及电缆
- 有源探头
- 低电流/电容模块
- 高压模块
- 激光修复
- 高清数字相机
- 探针卡/封装/PCB 板夹具
- Hot Chuck

(3) 兼容测试仪器:

- 各种型号示波器
- 各种品牌型号的源表
- 是德 B1500、4155、4156
- 泰克 4200

●各品牌的网络分析仪

(4) 尺寸示意图:

